

tML® - LWL TAP Modul MPO/MTP® m. Pins 3-fach 9/125µ OS2 40GBASE-LR4 50:50



tML® - tde Modular Link

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML®-Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® Xtended System, tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Das tML®- LWL TAP Modul ist für den Einbau im 1HE tML® - Modulträger (für 8 x Module) vorgesehen.



tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - LWL TAP Modul MPO/MTP[®] m. Pins 3-fach 9/125µ OS2 40GBASE-LR4 50:50

Technische Daten

Eingang	3 x MPO/MTP [®] mit Pins (schwarz) frontseitig
Ausgang	6 x MPO/MTP [®] mit Pins (grün) frontseitig
Tests	Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Frontplattenfarbe	Edelstahl
Abmessungen	110 x 108 x 20 mm

LWL Adapter

Typ	MPO/MTP [®]
Anwendung	Singlemode OS2 APC
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ A, Key up/down
Farbe	Grün
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

LWL Adapter

Typ	MPO/MTP [®]
Anwendung	Multimode
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ A, Key up/down
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

LWL Steckverbinder

tML[®] - LWL TAP Modul MPO/MTP[®] m. Pins 3-fach 9/125µ OS2 40GBASE-LR4 50:50

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP[®] Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.

Stecker

Stecker	MPO/MTP [®] APC Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (Grün)
Ferrule	12 Faser SM Elite [®] Ferrule, PPS
Tüllenfarbe	Schwarz
Temperaturbereich	-40°C bis +75°C
Hersteller	tde/US Conec

Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
9/125µ OS2	MPO/MTP [®] APC	1550 nm	≤ 0.10 dB	0.25 dB	75 dB

LWL Splitter

Typ	PLC Splitter
Port	1x2 (50:50)
Faserlänge	1.0 m
Betriebswellenlänge	1260 ~ 1650 nm
Einfügedämpfung	typ. 3.6 dB / max. 4.3 dB
Max. Gleichmäßigkeit	0.5 dB
Max. PDL	0.2 dB
Max. TDL	0.5 dB
Rückflussdämpfung	≥ 55 dB (APC) / ≥ 50 dB (UPC)
Direktivität	≥ 55 dB
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Abmessungen	40mm x 4mm x 4mm

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-M03MPP09E-TAP50	tML [®] - LWL TAP Modul MPO/MTP [®] m. Pins 3-fach 9/125µ OS2 40GBASE-LR4 50:50
TML-M03MPP09E-TAP70	tML [®] - LWL TAP Modul MPO/MTP [®] m. Pins 3-fach 9/125µ OS2 40GBASE-LR4 30:70
TML-M03MPP50G4TAP50	tML [®] - LWL TAP Modul MPO/MTP [®] m. Pins 3-fach 50/125µ OM4 40GBASE-SR4 50:50
TML-M03MPP50G4TAP70	tML [®] - LWL TAP Modul MPO/MTP [®] m. Pins 3-fach 50/125µ OM4 40GBASE-SR4 30:70